

For IC package high thermal conductive insulation sheet materials

半導体パッケージ向け 高熱伝導性絶縁シート材料

EcooL-Sheet

CV2079

High heat dissipation
高放熱性

High fluidity
高流動

Thermosetting sheet material
熱硬化性シート材

Proposals 提案

1. Attaches strongly to the adherend by thermocompression molding to form an insulated layer that has high thermal conductivity, dielectric strength and low linear expansion properties.
2. Decreases thermal contact resistance because it is filled without gaps in the shape of the adherend due to excellent fluidity on heating.

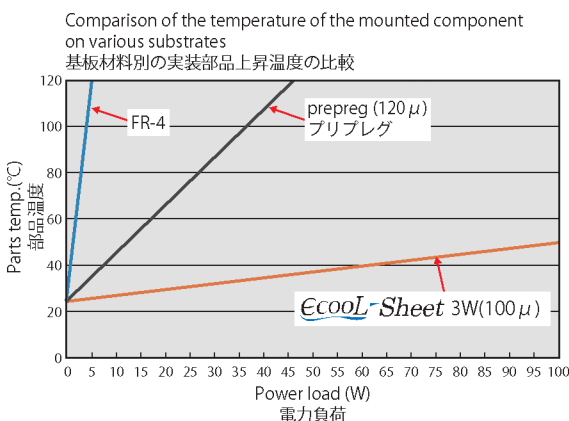
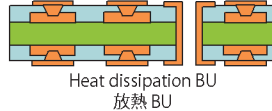
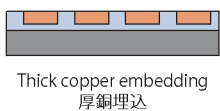
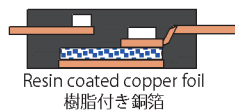
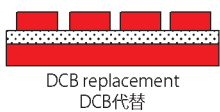
1. 熱圧着成形により被着体に強固に接着し、高熱伝導、高耐電圧、低熱膨張特性を有する絶縁層を形成します。
2. 加熱時の優れた流動性により、被着体の形状に隙間なく樹脂が充填されるため接触熱抵抗を低減。

Applications 用途

Power module, Large-current substrate

パワーモジュール、大電流基板

General properties 一般特性



Parts area : 10mm² (ideal heat dissipation)
部品面積 : 10mm² (理想放熱状態)

Item 項目	Test method 試験方法	Unit 単位	EcooL-Sheet 3W	EcooL-Sheet 5W	
Thermal conductivity 熱伝導率	Laser flash	W/m·K	3.2	5.0	
Glass transition temp (Tg) ガラス転移温度	JIS K6911	°C	210	190	
CTE (X, Y, Z axis) 熱膨張係数 (X, Y, Z方向)	JIS K6911	ppm/°C	α1	13	12
			α2	35	30
Dielectric constant (Dk) 比誘電率	1MHz	-	7.2	8.3	
Dissipation factor (Df) 誘電正接			0.006	0.006	
Maximum resistance voltage 絶縁破壊電圧	150 μm	JIS K6911	kV	7	7
Flexural modulus 曲げ弾性率	JIS K6911	GPa	26	33	
Flexural strength 曲げ強度	JIS K6911	MPa	190	200	
Peel strength 銅箔引き剥がし強さ	1oz	JIS K6911	N/cm	19	18
Deflection たわみ量	JIS K6911	mm	0.6	0.6	
Fluidity 流動性	Internal method	%	73	62	
Product thickness 製品厚	Internal method	μm	50,100,150	100,150	

The sample thickness is 2mm 試験片の厚さは2mmです。
<Condition 条件> As received

The above data is actual values and not guaranteed values. 上記データは実際の実測値であり、保証値ではありません。

More Product line from Panasonic 関連商品

Epoxy resin insulation sheet material ECOM Fine Sheet

Please see the page for "Notes before you use" 商品のご採用に当たっての注意事項はこちら

エポキシ樹脂絶縁シート材料 ECOM Fine Sheet

page 22